

2016-2022年中国半导体用 环氧塑封料（EMC）市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2016-2022年中国半导体用环氧塑封料（EMC）市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitahuagong1510/Z751046745.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-10-12

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2016-2022年中国半导体用环氧塑封料（EMC）市场分析与投资前景研究报告》共八章。报告介绍了半导体用环氧塑封料（EMC）行业相关概述、中国半导体用环氧塑封料（EMC）产业运行环境、分析了中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业的现状、中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业竞争格局、对中国半导体用环氧塑封料（EMC）行业做了重点企业经营状况分析及中国半导体用环氧塑封料（EMC）产业发展前景与投资预测。您若想对半导体用环氧塑封料（EMC）产业有个系统的了解或者想投资半导体用环氧塑封料（EMC）行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

环氧模塑料（EMC - Epoxy Molding Compound）即环氧树脂模塑料、环氧塑封料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等为填料，以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。塑料封装（简称塑封）材料97%以上采用EMC，塑封过程是用传递成型法将EMC挤压入模腔,并将其中的半导体芯片包埋，同时交联固化成型，成为具有一定结构外型的半导体器件。目前EMC绿色无卤无锑化进程在加快，中外行业重新洗牌。

报告目录：

第一章环氧塑封料产品概述 12

1.1环氧塑封料产品定义 12

1.2环氧塑封料的发展历程与产业现况 12

1.3环氧塑封料技术发展趋势 27

1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位 27

第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程 29

2.1环氧塑封料产品组成 29

2.2环氧塑封料产品品种分类 29

2.2.1以分立器件封装和集成电路封装两类分类 29

2.2.2以EMC所采用的环氧树脂体系分类 29

2.2.3以芯片封装外形以及具体应用分类 30

2.2.4以EMC的不同性能分类 32

2.3环氧塑封料制作过程 32

2.4环氧塑封料产品性能 35

2.4.1未固化物理性能 35

2.4.2固化物理性能 36

2.4.3机械性能 36

第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域 37

3.1IC封装的塑封成形工艺过程 37

3.1.1IC封装塑封成形的工艺过程 37

3.1.2IC封装塑封成形的工艺要点 38

3.1.3IC封装塑封成形的质量保证 39

3.2环氧塑封料的应用领域 40

3.2.1分立器件封装 40

3.2.2集成电路封装 41

第四章全球半导体封测产业概况及市场分析 45

4.1世界半导体封装业发展特点 45

4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商 46

4.3世界半导体封装业的发展现状 50

4.3.12014年世界半导体产业与市场概况 50

4.3.2世界封测产业与市场概况 52

4.4世界封测产业的发展总趋势 54

4.5世界封测生产值统计 55

第五章我国半导体封测产业概况及市场分析 57

5.12014年我国半导体产业发展状况 57

5.2我国集成电路封测业发展现况 62

5.2.1我国集成电路产业发展 62

5.2.2我国集成电路封测产业发展现况 68

- 5.2.2.1我国IC封测产业市场规模现状 68
- 5.2.2.2我国IC封测厂家分布及产能 69
- 5.2.2.3我国IC封测业的骨干生产企业情况 70
- 5.2.2.4我国IC封测业内资企业在近期的技术发展 72
- 5.3我国半导体分立器件封测业发展现况 74
- 5.3.1我国半导体分立器件生产现况 74
- 5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点 78
- 5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构 80
- 5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况 80
- 5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景 81

第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状 83

- 6.1世界环氧塑封料生产与市场总况 83
- 6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述 84
- 6.3日本环氧塑封料生产厂家现状 84
- 6.3.1住友电木 (SumitomoBakelite) 84
- 6.3.2日东电工 (NittoDenko) 85
- 6.3.3日立化成 (HitachiChemical) 85
- 6.3.4松下电工株式会社 (MatsushitaElectric) 86
- 6.3.5信越化学工业 (Shin-EtsuChemical) 87
- 6.3.6京瓷化学 (KyoceraChemical) 89
- 6.4台湾环氧塑封料生产厂家现状 90
- 6.4.1长春人造树脂 90
- 6.4.2台湾其它环氧塑封料生产厂家现状 91
- 6.5韩国环氧塑封料生产厂家现状 92
- 6.5.1韩国环氧塑封料生产厂家情况总述 92
- 6.5.2三星集团第一毛织 92
- 6.5.3韩国KCC 93
- 6.6欧美塑封料生产厂家现状 96
- 6.6.1汉高集团 (Hysol) 96
- 6.6.2欧美其它环氧塑封料生产厂家现状 97

第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求 99

- 7.1我国环氧塑封料业的发展现状 99
- 7.2我国环氧塑封料业生产企业情况 100
- 7.3我国环氧塑封料业技术水平现况 101
 - 7.3.1国内不同性质企业的EMC产品水平分析 101
 - 7.3.2国内不同性质企业的EMC技术与产品结构现况 102
 - 7.3.3国内不同性质企业在EMC产品与技术研发能力的现况 103
- 7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况 103
- 7.5未来几年我国环氧塑封料行业的发展趋势预测 104
- 7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况 105
 - 7.6.1汉高华威电子有限公司 105
 - 7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司 106
 - 7.6.3住友电木(苏州)有限公司 107
 - 7.6.4日立化成工业(苏州)有限公司 108
 - 7.6.5北京首科化微电子有限公司 109
 - 7.6.6佛山市亿通电子有限公司 109
 - 7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司 110
 - 7.6.8江苏中鹏电子有限公司 111
 - 7.6.9江苏晶科电子材料有限公司 111
 - 7.6.10广州市华塑电子有限公司 112
 - 7.6.11松下电工(上海)电子材料有限公司 112
 - 7.6.12北京中新泰合电子材料科技有限公司 113
 - 7.6.13长春封塑料(常熟)有限公司 113
 - 7.6.14无锡创达电子有限公司 114
 - 7.6.15广东榕泰实业股份有限公司 114

第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求 116

- 8.1EMC用环氧树脂 116
 - 8.1.1EMC对环氧树脂原料的要求 116
 - 8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状 117

8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况 121

8.1.3.1双酚A 121

8.1.3.2环氧氯丙烷（ECH） 130

8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况 131

8.2EMC用硅微粉 137

8.2.1EMC对硅微粉原料的要求 137

8.2.2EMC用硅微粉产品概述 137

8.2.3国外EMC用硅微粉产品生产的现况 138

8.2.3.1日本EMC用硅微粉的生产现况 138

8.2.3.2北美EMC用硅微粉的生产现况 138

8.2.3.3欧洲EMC用硅微粉的生产现况 139

8.2.4国内EMC用硅微粉产品生产的现况 139

图表报告：

图表1：2015年中国GDP 12

图表2：2010-2014年国内生产总值及其增长速度 13

图表3：2014年居民消费价格月度涨跌幅度 13

图表4：2014年居民消费价格比上年涨跌幅度 14

图表5：2014年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比 15

图表6：2010-2014年全部工业增加值及其增长速度 16

图表7：2014年主要工业产品产量及其增长速度 16

图表8：2010-2014年全国一般公共预算收入 18

图表9：2010-2014年全年社会消费品零售总额 19

图表10：2010-2014年货物进出口总额 20

图表11：2014年货物进出口总额及其增长速度 20

图表12：2014年主要商品出口数量、金额及其增长速度 20

图表13：2014年主要商品进口数量、金额及其增长速度 21

图表14：2014年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 21

图表15：2015年中国固定资产投资 22

图表16：2010-2014年全社会固定资产投资 23

图表17：2014年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度 23

图表18：2014年固定资产投资新增主要生产与运营能力 24

- 图表19：环氧塑封料产品组成 29
- 图表20：IC封装塑封成形的工艺过程 37
- 图表21：封装技术应用领域及代表性封装型式 53
- 图表22：2013-2015年全球半导体封测产值分析 55
- 图表23：2008-2014年我国集成电路行业增长情况 62
- 图表24：2014年我国集成电路出口情况 63
- 图表25：2014年集成电路产业内销产值增长情况 64
- 图表26：2008-2014年我国集成电路固定资产投资增长情况 64
- 图表27：2014年我国集成电路行业经济效益增长情况 65
- 图表28：国内IC封装测试业销售收入统计表 68
- 图表29：2014年中国集成电路产业三业占比情况 69
- 图表30：国内IC封装测试业销售收入统计 69
- 图表31：2015年1-5月全国半导体分立器件产量分省市统计表 74
- 图表32：2014年1-12月全国半导体分立器件产量分省市统计表 76
- 图表33：2013-2015年我国环氧塑封料需求量 103
- 图表34：各种结构的树脂对环氧模塑料性能的影响 116
- 图表35：2014年国内BPA市场走势图 122
- 图表36：2012-2014年BPA进口及均价图 123
- 图表37：上半年亚太地区主要双酚A装置检修统计表 124
- 图表38：2012-2014年主要进口来源对比 125
- 图表39：2014年国内新增苯酚丙酮产能统计表 126
- 图表40：下半年双酚A原料市场价格波动表 127
- 图表41：2007-2014年来自韩国BPA进口统计 129
- 图表42：燃烧过程示意图： 131
- 图表43：各种阻燃剂及其阻燃机理 132
- 图表44：各种阻燃剂性能比较 135
- 图表45：阻燃剂类型 135
- 图表46：几种无卤型阻燃剂对环氧塑封料性能影响比较 135
- 图表47：绿色环氧塑封料性能改进 136

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitahuagong1510/Z751046745.html>